

陶瓷封装外壳 电热陶瓷

产品名称	陶瓷封装外壳 电热陶瓷
公司名称	福建闽航电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:电热陶瓷 用途:广泛应用于中小规模的双极电路封装 特性:质量好、寿命长、高可靠、多品种
公司地址	福建省南平市长沙高新技术开发区
联系电话	0599-8609395 18960668996

产品详情

类别	电热陶瓷	用途	广泛应用于中小规模的双极电路封装
特性	质量好、寿命长、高可靠、多品种		

该系列产品广泛应用于中小规模的双极电路封装。

如运算放大器、a/d转换器等。具有质量好、寿命长、高可靠、多品种等特点：

功率型多层陶瓷dip封装外壳8-64线：主要用于中小型功率电路、也可用于汽车及音响电路封装。

光耦合器（黑瓷）外壳4-16线：主要用于光电耦合器封装。

dhc黑陶瓷组合电路外壳16-52线：用于高精度光电隔离传输组件及通讯组件封装。

cerdip黑陶瓷低熔玻璃熔封外壳14-40线，适用于中小规模集成电路封装。

sop小外形（即间距为1.27mm）系列外壳线8-64线，该外壳用于表面贴装（smt）。